



ESMC legt Grundstein für neue Fabrik in Dresden

DRESDEN, 20. August 2024 — ESMC – ein Gemeinschaftsunternehmen von TSMC (TWSE: 2330, NYSE: TSM), der Robert Bosch GmbH, der Infineon Technologies AG und NXP Semiconductors N.V. – hat heute in einer Zeremonie den Grundstein für seine erste Halbleiterfabrik in Dresden gelegt. Damit wurde die erste Phase der Vorbereitung der Baugrube offiziell eingeleitet. An der Zeremonie zur Feier dieses Meilensteins nahmen Regierungsvertreter, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und Vertreter der Universitäten aus der Region teil. Die Anlage wird die erste Pure-Play-Foundry in der EU sein, die in der Lage ist, Chips mit FinFET-Technologie zu produzieren.

„Zusammen mit unseren Partnern Bosch, Infineon und NXP bauen wir unsere neue Fabrik in Dresden, um den Halbleiterbedarf der schnell wachsenden europäischen Automobil- und Industriesektoren zu decken“, sagte TSMC-Chairman & CEO C.C. Wei. „Mit dieser hochmodernen Produktionsanlage werden wir die innovativen Fertigungsmethoden von TSMC viel näher zu unseren europäischen Kunden und Partnern bringen. Das wird die wirtschaftliche Entwicklung in der Region und den technologischen Fortschritt in ganz Europa vorantreiben.“

Wenn die ESMC-Fabrik voll betriebsbereit ist, wird sie voraussichtlich eine monatliche Produktionskapazität von 40.000 300mm (12-Zoll) Wafern auf der 28/22-Nanometer-Planar-CMOS- und 16/12-Nanometer-FinFET-Prozesstechnologie von TSMC haben, was das Halbleiterfertigungsökosystem Europas mit fortschrittlicher FinFET-Transistortechnologie weiter stärken wird. Die Gesamtinvestitionen werden voraussichtlich zehn Milliarden Euro übersteigen und bestehen aus Eigenkapitalzufuhr, Kreditaufnahme sowie signifikanter Unterstützung der Europäischen Union und der Bundesregierung.

Es wird erwartet, dass durch die neue Fabrik etwa 2.000 direkte High-Tech-Arbeitsplätze entstehen werden. Darüber hinaus wird jeder direkte Arbeitsplatz, der durch das Projekt entsteht, die Schaffung zahlreicher indirekter Arbeitsplätze entlang der gesamten EU-Lieferkette anregen, und so die Wirtschaft der Region stärken.



ESMC wird die Standards für Nachhaltigkeit und Umweltschutz von TSMC einhalten. Im Einklang mit dieser Mission haben sich die ESCM und ihre Partner dem Bau einer grünen Fabrik verschrieben, die sowohl bestehende als auch modernste Techniken zur Optimierung des Umweltschutzes einsetzt. Dazu gehört eine energieeffiziente Bauweise, innovative Lösungen zur Wasseraufbereitung und der Erhalt der LEED-Zertifizierung, die eine besonders ökologische Bauweise auszeichnet.

Die Gründung von ESCM verdeutlicht die Stärke der TSMC „Grand Alliance“, ein Innovationseckpfeiler der in der Halbleiterindustrie. Diese Allianz, bestehend aus Kunden, Entwicklungspartnern, Ausrüstern und Zulieferern, hat eine neue Ebene der Zusammenarbeit geschaffen und weitreichende Fortschritte ermöglicht. Mit der Investition in ESCM unterstreicht TSMC nicht nur sein Bekenntnis zur strategischen Partnerschaft, sondern auch sein Engagement für die Förderung von Innovationen in ganz Europa. Der Baubeginn wird noch in diesem Jahr erwartet.

„Die ESCM-Chipfabrik wird in direkter Nachbarschaft zu unserem Bosch-Halbleiterwerk in Dresden gebaut. Wir können ihr jetzt also unmittelbar beim Entstehen und Wachsen zusehen. Darauf freuen wir uns ebenso sehr wie auf die enge Zusammenarbeit mit den Partnern TSMC, Infineon und NXP. Gemeinsam bringen wir Europa in einer Schlüsselindustrie entscheidend voran und sichern die Verfügbarkeit von modernen Chips für die hiesige Industrie“, sagt Dr. Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH.

„Unsere gemeinsame Investition in Dresden stellt erneut die hohe Bedeutung des Silicon Saxony als Anziehungspunkt für führende internationale Halbleiterhersteller unter Beweis“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG. „Dass in Dresden mit der ESCM nun eine weitere Halbleiterfabrik entsteht, ist ein großer Erfolg für die Region. Denn so holen wir eine besonders relevante Halbleitertechnologie nach Europa, die in modernsten digitalen Chips zum Einsatz kommt. Die Investition wird zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und das Halbleiterökosystem im Silicon Saxony sowie in Deutschland und Europa insgesamt nachhaltig stärken.“



„Der heutige Tag ist ein historischer Meilenstein für die deutsche und europäische Mikroelektronik-Branche“, sagt Kurt Sievers, Präsident und CEO von NXP. „NXP ist stolz darauf, ein Teil des ESMC Joint Venture zu sein, das innovative Lösungen im Halbleiterbereich und neue Fertigungskapazitäten für Europas Schlüsselmärkte schaffen wird, insbesondere bei der Automatisierung und Elektrifizierung der Automobilindustrie sowie weiterer Industriesektoren. Der heutige Spatenstich in Dresden zum Bau der ersten europäischen Produktionsstätte von TSMC ist ein wichtiger Schritt hin zur Stärkung der digitalen Souveränität Europas.“

Über TSMC

TSMC ist ein Pionier des Pure-Play-Foundry-Geschäftsmodells, das 1987 mit TSMCs Gründung ins Leben gerufen wurde, und ist seither die weltweit führende dezidierte Halbleiter-Foundry. Mit branchenführenden Prozesstechnologien und einem Portfolio an Design-Enablement-Lösungen unterstützt das Unternehmen ein florierendes Ökosystem von globalen Kunden und Partnern, um das Innovationspotenzial in der globalen Halbleiterindustrie freizusetzen. TSMC ist ein auf der ganzen Welt engagiertes Unternehmen mit Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika.

Im Jahr 2023 setzte TSMC 288 verschiedene Prozesstechnologien ein und fertigte 11.895 Produkte für 528 Kunden, indem es eine breite Palette an modernen Prozesstechnologien sowie fortschrittlichen Spezial- und Packaging-Technologien anbot. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hsinchu, Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.tsmc.com>.

#



TSMC Pressesprecher:

Wendell Huang
Vice President and CFO
Tel: 886-3-505-5901

TSMC stellvtr. Pressesprecherin:

Nina Kao
Head of Public Relations
Tel: 886-3-563-6688 ext.712 5036
Mobile: 886-988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

Pressekontakt:

Ulric Kelly
Public Relations
Tel: 03-5636688 ext.712 6541
Mobile: 0978-111-503
E-Mail: ukelly@tsmc.com